

UF 88UL 超快速流動底部填充膠產品資料表

卓越的可靠性表現

相容於所有免清洗助焊劑

易於返修

簡介

UF 88UL 是一款超快速流動的毛細管底部填充膠，可在室溫下無需對基板進行預熱，即可填充進入 10 μ m 的微小間隙中。固化後，填充層內無任何空隙。固化後的 UF 88UL 具有優異的可返修性。UF 88UL 不僅可用作晶片級封裝(CSP)、球柵陣列(BGA)、堆疊封裝(PoP)、焊盤柵格陣列(LGA)以及部分倒裝晶片(Flip Chip)應用的底部填充材料；同時也適用於各類先進封裝形式(如記憶卡、晶片載體、混合電路及多晶片模組)中的裸晶片保護晶片。本產品專為高產能、環保生產環境而設計，特別適用於那些對製程速度及抗機械衝擊性能有著極高要求的應用場景。此材料易於點膠操作，可最大限度地降低封裝過程中產生的應力，並提供卓越的可靠性表現(例如優異的溫度循環性能)及出色的機械強度。與使用傳統焊膏的方案相比，採用此材料後的跌落測試性能提升了兩個數量級。

物理特性

产品名称	UF 88UL 膠合劑
外觀	紅色
未固化材料性能	
屬性	數值
比重(ASTM D 1475-60)	1.1 – 1.2 g/cc
黏度 (ASTM D-1384)	100 – 200 cp
毛細流動速率 (STM 777)	室溫底部填充
固化后材料性能	
搭接剪切強度 (FR4/FR4)	2000 psi

C.TE.(ASTM E 831) PPM/°C	$\alpha 1 = 55; \alpha 2 = 122$
玻璃化轉變溫度 (Tg) (ASTM D3418-82)	100 – 110°C
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	<5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	<5 ppm
Cl ⁻	<10 ppm
表面絕緣電阻 (J-STD-004)	經過

推薦固化工藝

10 分鐘 @ 135°C;

註:固化時間不包含接合部位達到所需固化溫度所需的時間。亦可評估其他的固化曲線。

儲存与保质期

若將材料存放於密封的原包裝容器中, 且溫度保持在 -20 °C, 則保存期限為 6 個月。若存放期超過此期限, 可能會導致黏度升高。請注意防潮、防止揮發及防止混入異物。揮發和污染可能會對這些產品的加工性能產生不利影響。

安全信息

UF 88UL 為一種環保、無毒材料。但在使用和操作過程中, 仍建議遵循一般工業衛生規範。有關更詳細的安全信息, 請參閱本產品的 SDS(安全數據表)。

包裝規格

UF 88UL 黏合劑提供 10cc 和 30cc 規格。如需訂購或獲取更多信息, 請聯繫 YINCAE。